

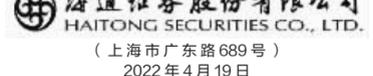


# 峰昭科技 (深圳) 股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板上市公告书

(深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园2期11栋203室)

### 保荐人(主承销商)



(上海市广东路689号)

2022年4月19日

#### 特别提示

峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称“峰昭科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

#### 一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

#### 二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解投资风险,理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制制度带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅限制比例为20%,首次公开发行上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险

上市初期,原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,发行人员工专项资产管理计划股份锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月。本公司发行后总股本为9,236.3380万股,其中本次新股上市初期的流通股数量为2,100.0787万股,占本次发行后总股本的比例为22.74%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率处于较高水平的风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(行业代码为“I65”)。截止2022年4月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(行业代码为“I65”)最近一个月平均动态市盈率为50.95倍。本次发行价格对应的市盈率为:

(1)72.50倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)80.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)96.66倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)107.36倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动,带来价格风险,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新增融资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例,流动性风险是指,本次股票发行副业价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券买券可能会受限,产生较大的流动性风险。

#### 三、特别风险提示

(一)以下所述“报告期”指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月。

(二)经营业绩难以持续高速增长的风险

2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月公司营业收入分别为9,142.87万元、14,289.29万元、23,396.09万元、18,192.72万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,148.32万元、2,931.89万元、7,054.74万元、7,171.03万元,最近三年发行人营业收入、净利润(扣非归母净利润)年均复合增长率分别为59.96%、147.86%。若下游发行人、竞争对手提出更具针对性竞争策略,或公司所处行业的产品政策发生持续性不利变化,或公司技术研发难以满足客户需求等,公司经营业绩高速增长将面临无法持续的风险。

(三)下游BLDC电机需求不及预期风险

发行人芯片产品主要用于BLDC电机驱动控制,产品需求与BLDC电机在下游终端领域的横向拓展、BLDC电机对传统电机的纵向渗透率提升等密切相关。BLDC电机驱动控制芯片增速=(1+电机整体增速)×(1+BLDC电机渗透率增速)-1。

报告期内,受益于BLDC电机在高速电风扇、直流变频电扇、无绳电动工具等终端领域的成功应用及渗透率提升,发行人芯片产品得到广泛应用,经营规模快速发展。若未来BLDC电机在发行人重点发展的终端领域渗透率尚未达到预期,或发行人在其他终端领域,如:汽车电子、工业控制等领域的拓展未达到预期,将对发行人持续经营能力造成不利影响。

发行人竞争对手多为海外知名芯片厂商,例如德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、英飞凌 Infineon)、赛普拉斯(Cypress)等,竞争对手大多采用通用MCU芯片的技术路线,一般采用ARM公司授权的Cortex-M系列内核;发行人则坚持专用化芯片研发路线,形成完全自主知识产权的芯片内核M8。发行人与竞争对手共同受益于下游行业旺盛需求所带来的商机,若竞争对手利用其雄厚技术实力及资金实力,丰富客户渠道,完善供应链等优势,亦加大专用化芯片竞争力,公司可能面临市场竞争加剧、市场份额萎缩等风险。

(四)供应商集中风险

公司产品的晶圆制造和封装测试等生产环节均由境内外行业领先的晶圆制造和封装测试厂商完成,公司与这些主要供应商保持长期稳定合作关系。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司向前五名供应商合计采购金额分别为4,738.73万元、8,956.46万元、10,467.53万元和6,458.60万元,占同期采购金额的67.85%、91.19%、88.19%和84.69%。

报告期内,公司主要的晶圆制造供应商为格罗方德(GF)和台积电(TSMC),公司主要通过进口方式采购晶圆;主要的封装测试供应商为华天科技、长电科技和日月光,各环节供应商集中度较高。

2021年鉴于公司产品供应缺口较大,公司与部分重要客户经过协商,就2022年全年供货达成协议。若上游晶圆厂商,受地缘政治或其他未公开说明的原因等因素影响,不按市场化的商业规则要求向公司提供晶圆,公司将面临无法及时接收向下游客户交付芯片产品的履约风险。

#### (五)研发风险

由于发行人采用专用芯片设计路线,市场上没有与之相匹配的成熟可靠的IP核与软件库可以直接授权使用,需要研发团队长时间的自主研发与经验积累。BLDC电机驱动控制芯片基础研发投入较大,研发周期较长,开发成本较高。芯片设计研发能力建立在不同应用场电机智能化控制需求,对电机控制算法、电机技术等专业结合的深度理解,需要芯片设计、算法团队、电机技术三方面研发力量深度融合,对复合型人才以及多方面技术力量协调配合提出了较高的要求;若发行人无法对研发团队、研发人员、研发力量进行有效整合管理,导致无法及时响应市场需求及时推出新的芯片产品,将对公司持续创新研发、产品迭代更新造成不利影响。

(六)售价或毛利率波动风险

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司主营业务毛利率分别为44.55%、47.53%、50.10%和54.75%,各期毛利率稳定增长。随着市场竞争加剧,公司必须根据市场需求不断进行技术创新,若公司未能平衡下游需求变化,或公司产品技术竞争力持续不强,或公司未能有效控制生产成本,或公司产品市场供需格局发生变化等导致公司发生生产售价下降、产品结构向低毛利产品、产品品类等不利情形,公司产品销售价格或毛利率存在下滑风险。

当前全球芯片行业上游晶圆制造和封装测试等委外加工的生产趋于紧张,投产周期延长,公司采购价格存在大幅上涨风险,公司在执行“成本+目标毛利率区间”的定价策略下,采购价格的持续增长将导致销售价格的上升,若销售价格涨幅不及采购价格涨幅,公司销售毛利率存在下滑风险。

#### 第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年3月4日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]457号《关于同意峰昭科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。

具体内容包括:

一、同意你公司首次公开发行股票注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】1104号批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为9,236.3380万股(每股面值1.00元),其中2,100.0787万股将于2022年4月20日上市交易。证券简称为“峰昭科技”,证券代码为“688279”。

二、股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2022年4月20日

(三)股票简称:峰昭科技,扩位简称:峰昭科技

(四)股票代码:688279

(五)本次公开发行的总股本:9,236.3380万股

(六)本次公开发行的股票数量:2,309.0850万股

(七)本次上市的非流通限制及限售安排:2,100.0787万股

(八)本次上市的非流通限制或限售安排:2,100.0787万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获配售的股票数量:1,105.2065万股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:峰昭科技、芯运科技限售期为36个月,其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资有限公司所持

731,707股股份限售期24个月;发行人高管核心员工专项资产管理计划所持373,498股股份限售期12个月。(2)网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户承诺持有本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行参与网下配售的共2,046个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为206个,根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为984,868股,占网下发行总量的7.09%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.48%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:海通证券股份有限公司

#### 三、上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为76.74亿元,公司2020年度经审计的营业收入为23,396.09万元,2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,054.74万元。最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准:

(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

### 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

#### 一、发行人概况

英文名称	Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
所属行业	软件和信息技术服务业(I65)
经营范围	从事电子电气电子产品、集成电路、软件产品的技术开发、设计、销售自行研发的产品,提供相关技术咨询与服务(以上不含限制项目);从事贸易、技术进出口业务(不含国家专项规定)
主营业务	公司长期从事BLDC电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售业务,公司以芯片设计为立足点向电机驱动延伸,发展为系统级服务供应商,公司产品广泛应用于家电、电动工具、计算机及通信领域,驱动执行、工业控制等领域。
发行前注册资本	6,927.2830万元
法定代表人	田洪良
成立日期	2010年08月24日
整体变更日期	2020年08月24日
住所	深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园(二期)11栋203室
邮政编码	518000
电话	0755-86811588
传真	0755-26897777
互联网网址	www.fortior.com.cn
电子邮箱	fortior@fortior.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门/负责人(董事会秘书)和电话/邮箱	证券部,黄丹红,0755-86811588-4201

(一)发行人控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为峰昭香港,峰昭香港直接持有发行人3,515.4431万股股份,公司的实际控制人为BI LEI(毕皓),BI CHAO(毕超)和高帅,BI LEI(毕皓)和BI CHAO(毕超)系同胞兄弟关系,BI LEI(毕皓)和高帅系夫妻关系,BI LEI(毕皓)和BI CHAO(毕超)合计持有控股股东峰昭香港35.00%的股权,通过峰昭香港控制发行人35.06%10%的股份表决权,高帅持有芯运科技100%的股权,通过芯运科技控制发行人1.4624%的股份表决权,实际控制人BI LEI(毕皓)、BI CHAO(毕超)和高帅合计控制发行人39.5234%的股份表决权。

截至本上市公告书签署日,各员工持股平台全体持股员工出资及变更的工商登记已完成,出资人均为已实际出资,各员工持股平台全体持股员工出资及变更的工商登记已完成,出资人均为已实际出资,各员工持股平台全体持股员工出资及变更的工商登记已完成,出资人均为已实际出资。

#### 2、芯晟投资

企业名称	深圳市芯晟投资企业(有限合伙)
成立日期	2018年11月1日
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	28,706.2元
实缴出资额	28,706.2元
住所	深圳市福田区香梅路海通大厦2088号附层和自由“海通大厦2088”
执行事务合伙人	田洪良
投资范围	股权投资(不含限制项目);创业投资(不含限制项目)。
主营业务	作为员工持股平台管理峰昭科技
与发行人主营业务的关系	无

截至本上市公告书签署日,芯晟投资的合伙人及出资情况如下:

序号	姓名/名称	出资额(万元)	出资比例	出资人类型
1	田洪良	0.1026	0.3576%	普通合伙人
2	何建强	4.0000	13.9348%	有限合伙人
3	李勇	3.0000	10.4511%	有限合伙人
4	魏勇	2.5000	8.7092%	有限合伙人
5	林强	2.5000	8.7092%	有限合伙人
6	李勇	2.5000	8.7092%	有限合伙人
7	李勇	2.5000	8.7092%	有限合伙人
8	许伟峰	2.5000	8.7092%	有限合伙人
9	肖峰	2.5000	8.7092%	有限合伙人
10	肖峰	2.5000	8.7092%	有限合伙人
11	肖峰	2.5000	8.7092%	有限合伙人
12	黄晓英	1.0000	3.4857%	有限合伙人
13	杨文宇	0.5000	1.7419%	有限合伙人
14	黄丹红	0.1026	0.3574%	有限合伙人
合计		28,706.2	100.0000%	-

(二)员工持股平台确认股份支付

前述员工持股平台系通过受让深圳微禾、博创创投、芯运科技成为公司股东,转股价格低于前次外商股人入股价格,公司已确认股份支付费用。

(三)员工持股平台不属于私募投资基金

上述员工持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金,无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定办理私募投资基金备案。

(四)员工持股平台的股份锁定承诺

员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

#### 五、本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前总股本为69,272,530股,本次发行23,090,850股新股,占发行后总股本的比例25.00%,发行人股东不公开发售老股,本次发行前后公司股本结构如下表:

序号	股东名称	发行前股本情况	发行后股本情况	限售期	
		股数(万股)	比例		
一、有限售条件A股流通股					
1	峰昭香港	3,515.4431	38.0106%	自上市之日起36个月	
2	上海华芯	1,346.723	14.6711%	自上市之日起12个月	
3	芯晟投资	401.2000	6.0478%	自上市之日起12个月	
4	深圳微禾	270.2500	2.9256%	自上市之日起12个月	
5	博创创投	207.5881	2.9922%	自上市之日起12个月	
6	芯运科技	146.0750	2.1082%	自上市之日起12个月	
7	小泉资本	138.0716	1.9924%	自上市之日起12个月	
8	德威创投	128.2739	1.8527%	自上市之日起12个月	
9	青岛康达	103.7911	1.4981%	自上市之日起12个月	
10	祺联盛通	93.7125	1.3526%	自上市之日起12个月	
11	鼎源隆	90.9836	1.3120%	自上市之日起12个月	
12	创源一号	77.9343	1.1236%	自上市之日起12个月	
13	展一展	77.9343	1.1236%	自上市之日起12个月	
14	永泰资本	63.8866	0.9214%	自上市之日起12个月	
15	祺联盛通	46.9892	0.6771%	自上市之日起12个月	
16	源欣投	44.6594	0.6429%	自上市之日起12个月	
17	日耀创投	31.3337	0.4494%	自上市之日起12个月	
18	芯晟投资	28.7062	0.4144%	自上市之日起12个月	
19	伊德泰达	28.1342	0.4060%	自上市之日起12个月	
20	德威创投	25.9448	0.3736%	自上市之日起12个月	
21	海通创新证券承销科技1号员工专项资产管理计划	-	73,1707	0.7922%	自上市之日起24个月
22	海通创新证券承销科技1号员工专项资产管理计划	-	37,3498	0.4044%	自上市之日起12个月
23	小泉资本	-	98,8486	1.0693%	自上市之日起6个月
24	小泉资本	-	2,100.0787	22.7271%	-
合计		6,927.2830	100.00%	9,236.3380	100.00%

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人員基本情况及持股情况

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人員的基本情况

截至本上市公告书签署日,本公司董事由5名董事组成,包括2名独立董事;监事会由3名监事组成,包括1名职工代表监事;高级管理人员3名,包括1名总经理、1名董事会秘书、1名财务总监;核心技术人員3名。具体情况如下:

1、董事情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	本任期
1	田洪良(毕皓)	董事长、总经理	2020年6月至2023年6月
2	田洪良(毕皓)	董事	2020年6月至2023年6月
3	王强	董事	2020年6月至2023年6月
4	王强	独立董事	2020年6月至2023年6月
5	王强	独立董事	2020年6月至2023年6月

2、监事情况

截至本上市公告书签署日,发行人监事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	本任期
1	董开君	监事会主席	2020年6月至2023年6月
2	黄晓英	监事	2020年6月至2023年6月
3	刘明辉	职工代表监事	2021年7月至2023年6月

3、高级管理人员情况

截至本上市公告书签署日,高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务	本任期
1	田洪良(毕皓)	董事长、总经理	2020年6月至2023年6月
2	黄丹红	董事会秘书、副总经理	2020年6月至2023年6月
3	林强	财务总监	2020年6月至2023年6月

4、核心技术人員情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人員的基本情况如下:

序号	姓名	职务	本任期
1	BI LEI(毕皓)	董事长、总经理兼首席执行官	-
2	BI CHAO(毕超)	董事、首席技术官	-
3	SHI CHENGBING(石苏楠)	首席运营官	-

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人員持有公司股份情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人員及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属间持有发行人股份的具体情况如下:

序号	姓名	与公司关系	持股数量(万股)	持股比例
1	田洪良(毕皓)	实际控制人、董事长兼总经理	1,229.1054	17.8977%
2	BI CHAO(毕超)	实际控制人、董事	1,522.8677	21.9852%
3	董开君	监事会主席	2,229.0	32.428%
4	黄晓英	监事	1.00	0.0144%
5	刘明辉	职工代表监事	10.23	0.1477%
6	黄丹红	副总经理兼董事会秘书	7.0036	0.1097%
7	林强	财务总监	8.53	0.1231%
8	SHI CHENGBING(石苏楠)	财务总监	165.2258	2.3825%
9	高帅	实际控制人、BI LEI(毕皓)兄弟	201.6316	2.9107%

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属所持股份不存在质押或冻结的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人員持有发行人股份的限售安排

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属所持股份不存在质押或冻结的情况。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

(一)员工持股平台基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人设立了员工持股平台芯晟投资、芯晟投资。各平台基本情况如下:

#### 1、芯晟投资

企业名称	深圳市芯晟投资企业(有限合伙)
成立日期	2017年11月3日
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	401.20万元
实缴出资额	401.20万元
住所/生产经营地	深圳市福田区香梅路海通大厦2088号附层20212
执行事务合伙人	田洪良
投资范围	股权投资(不含限制项目);创业投资(不含限制项目)。
主营业务	作为员工持股平台管理峰昭科技
与发行人主营业务的关系	无

截至本上市公告书签署日,截至本上市公告书签署日,芯晟投资的全体合伙人及出资情况如下:

序号	姓名/名称	出资额(万元)	出资比例	出资人类型
1	田洪良	12.30	2.5566%	普通合伙人
2	何建强	153.14	31.8187%	有限合伙人
3	李勇	63.65	13.2025%	有限合伙人

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例	出资人类型
4	董开君	2250	46.749%	有限合伙人
5	胡永云	2250	46.749%	有限合伙人
6	李艺豪	15.50	3.2012%	有限合伙人
7	李宇	13.00	2.7011%	有限合伙人
8	罗敏	12.00	2.4033%	有限合伙人
9	刘明辉	10.10	2.1816%	有限合伙人
10	郭海梅	10.23	2.126%	有限合伙人
11	程春生	9.00	1.8700%	有限合伙人
12	陈亮	9.00	1.8700%	有限合伙人
13	王强	8.50	1.7429%	有限合伙人
14	张瑞强	9.00	1.8700%	有限合伙人
15	林强	8.53	1.7223%	有限合伙人
16	黄晓英	8.00	1.6622%	有限合伙人
17	黄丹红	7.50	1.5883%	有限合伙人
18	王延佳	7.20	1.4960%	有限合伙人
19	宋金旺	7.20	1.4960%	有限合伙人
20	庄国涛	7.16	1.4877%	有限合伙人
21	张月坤	6.48	1.3464%	有限合伙人
22	胡斌	6.50	1.3428%	有限合伙人
23	李勇	6.50	1.3428%	有限合伙人
24	李勇	6.50	1.3428%	有限合伙人
25	张强	4.80	0.9972%	有限合伙人
26	刘明	4.70	0.956%	有限合伙人
27	程春生	4.50	0.9505%	有限合伙人
28	何永玉	3.50	0.7223%	有限合伙人
29	陈苏华	3.00	0.6223%	有限合伙人
30	李强	3.00		